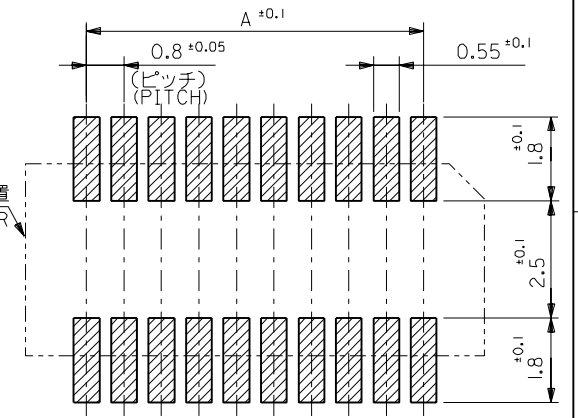
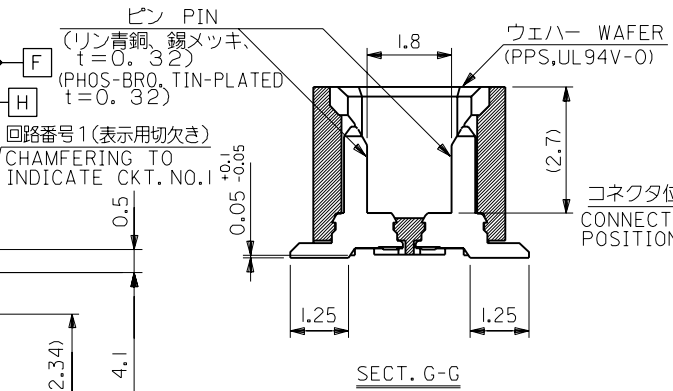


注記 NOTES
 1. 嵌合相手: 52465,52588
 MATE WITH: 52465,52588 SERIES
 △ ウエハーの ϕ から隣接するピンの ϕ 迄の位置を示す。
 SHOW POSITION FROM ϕ OF WAFER TO ϕ OF ADJACENT PINS.



参考基板レイアウト (マウント面)
 P.C.B. PATTERN LAYOUT (REF.) (MOUNT AREA)

0.4	17.8	16.9	15.2	53307-4027	40
0.4	16.2	15.3	13.6	-3627	36
0.8	15.4	14.5	12.8	-3427	34
0.8	13.8	12.9	11.2	-3027	30
0.4	13.0	12.1	10.4	-2827	28
0.8	12.2	11.3	9.6	-2627	26
0.4	11.4	10.5	8.8	-2427	24
0.8	10.6	9.7	8.0	-2227	22
0.4	9.8	8.9	7.2	-2027	20
0.8	9.0	8.1	6.4	-1827	18
0.4	8.2	7.3	5.6	-1627	16
0.8	7.4	6.5	4.8	-1427	14
0.4	6.6	5.7	4.0	-1227	12
0.8	5.8	4.9	3.2	53307-1027	10
D	C	B	A	ENG. NO.	極数 CKT.

角度 ANGLE	±3°				
30以上 OVER	+0.3	B	変更 REVISION (JCT0882)	97/4/1	
10以上 30未満 UNDER	+0.25	A	変更 REVISION (JC60094)	95/8/9	
10未満 UNDER	+0.2	O	新規作成 PROPOSED (J1100)	91/11/16	
一般公差 GENERAL TOLERANCES		記号 LTR	変更内容 REVISION RECORD	DR. DATE	日付 DATE

材料 MATERIAL	☑中参照 SEE DRAWING
仕上げ FINISH	—
適用電線範囲 WIRE RANGE	—
被覆外径 INS. RANGE	—
DRAWN BY '91/11/14	CHK'D BY '97/4/1
K.ASAKAWA	Y.MIZUNO
APP'D BY '97/4/1	尺度 SCALE
M.FUKUSHIMA	—

molex MOLEX-JAPAN CO.,LTD.
 日本モレックス株式会社

REVISE ONLY ON CAD SYSTEM

TITLE 名称
 0.8 BOARD TO BOARD CONN.
 WAFER ASS'Y ST. SMT
 (WITHOUT BOSS)

DWG. NO. (SHEET 1 OF 2) REV
 SD-53307-**-27 B

DWG. NO. SD-53307-***27

E

D

C

B

A

DIMENSIONS IN METRIC DO NOT SCALE DRAWING

8 7 6 5 4 3 2 1

F

E

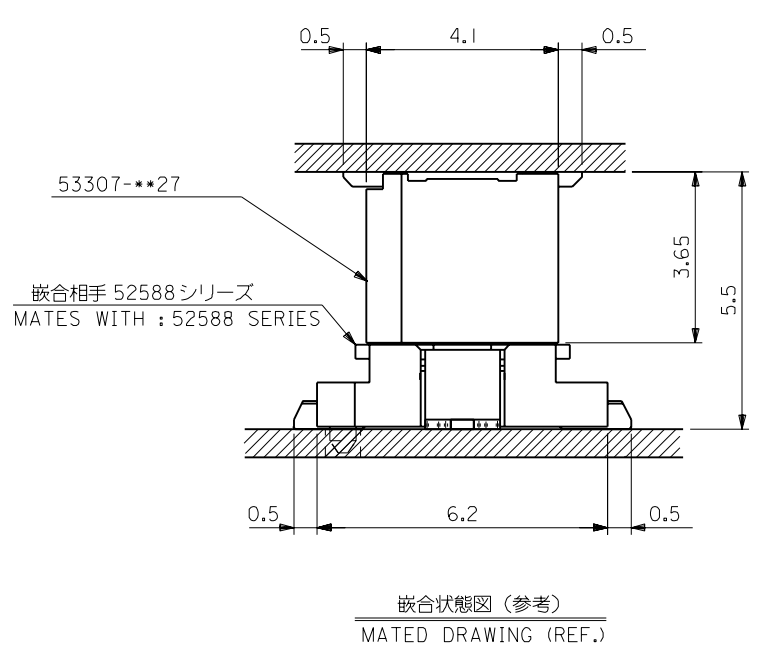
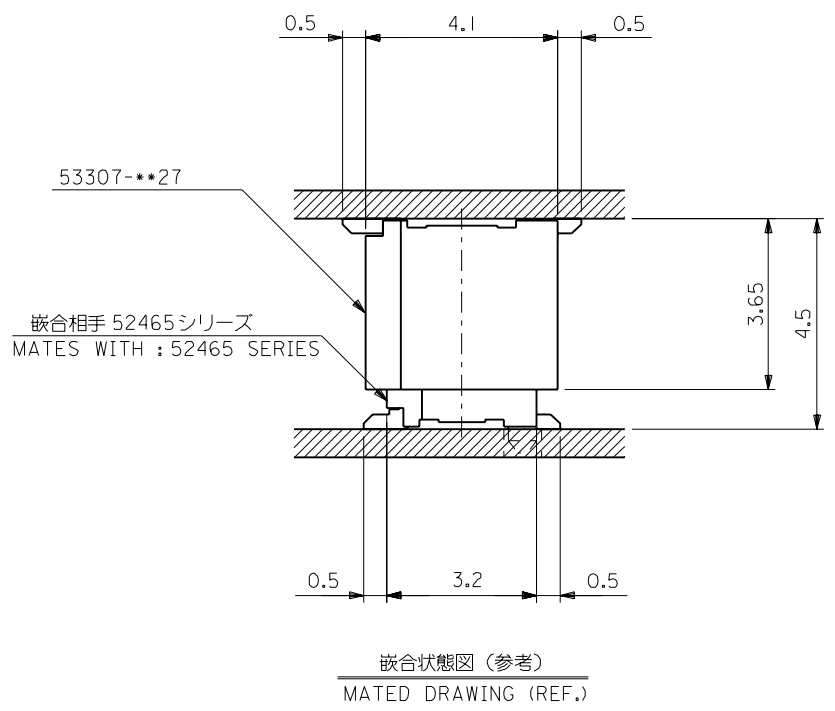
D

C

B

A

A53307.S10



角度 ANGLE		13°				材料 MATERIAL	MOLEX-JAPAN CO.,LTD. 日本モレックス株式会社
30°以上 OVER	+0.3	B	変更 REVISD (JCT0882)	N.H.	97/4/1	SHEET 1 OF 2参照 REFER TO SHEET 1 OF 2	
10°以上 30°未満 UNDER	+0.25	A	変更 REVISD (JC60094)	N.H.	95/8/9	仕上げ FINISH	REVISE ONLY ON CAD SYSTEM
10°未満 UNDER	+0.2	O	新規作成 PROPOSED (J11001)	N.H.		適用電線範囲 WIRE RANGE	TITLE 名称
一般公差 GENERAL TOLERANCES			記号 LTR	変更内容 REVISION RECORD	DR. CHR.	日付 DATE	0.8 BOARD TO BOARD CONN. WAFER ASS'Y ST. SMT (WITHOUT BOSS)
						DRAWN BY '91/11/14 K.ASAKAWA	CHK'D BY '97/4/1 Y.MIZUNO
						APP'D BY '97/4/1 M.FUKUSHIMA	尺 度 SCALE
							DWG. NO. (SHEET 2 OF 2) REV SD-53307-***27 B

THIS DRAWING CONTAINS INFORMATION THAT IS PROPRIETARY TO MOLEX(JAPAN) AND SHOULD NOT BE USED WITHOUT WRITTEN PERMISSION
本図面は日本モレックス(株)の所有する情報を含むもので 当社の許可なく複製を禁止する。
EN-01C(032)MXJ-32

8 7 6 5 4 3 2 1

DWG. NO.
SD-53307-***9I

E

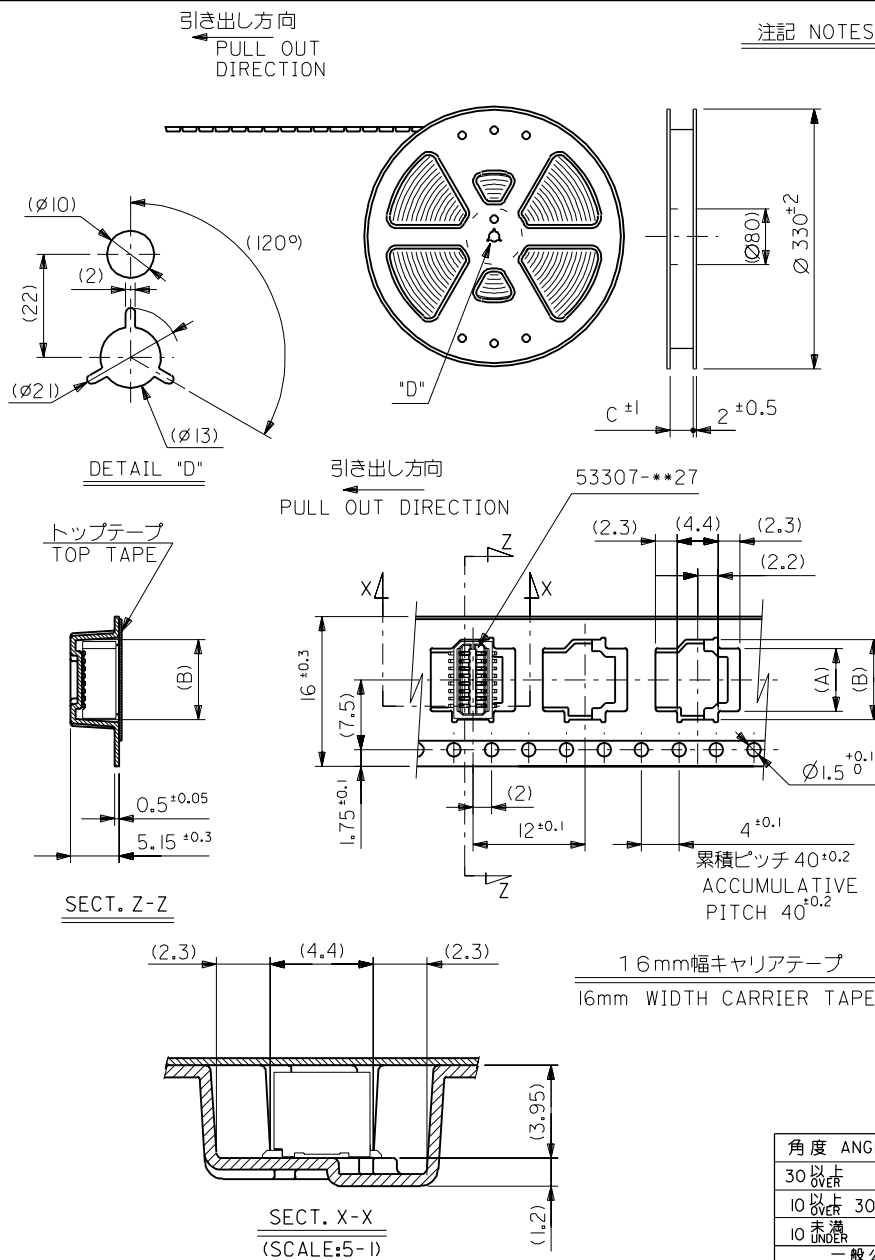
D

C

B

A

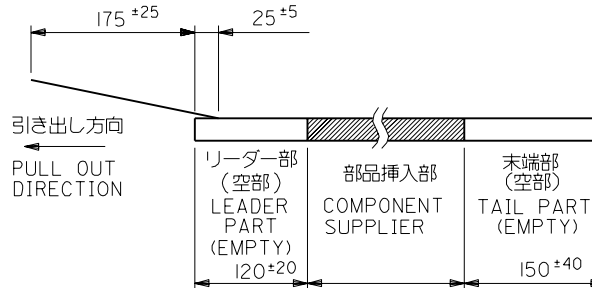
DIMENSIONS IN METRIC DO NOT SCALE DRAWING



注記 NOTES

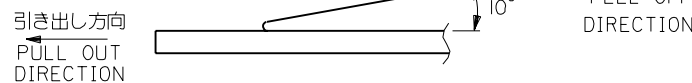
1. 梱包数量：1000個/リール NUMBER OF CONNECTORS:1000PCS/REEL
2. リードテープ長さ LEAD TAPE LENGTH

トップテープ リーダー部 TOP TAPE LEADER PART
トップテープ 未接着部 TOP TAPE NON-BONDED PART



3. トップテープの剥離強度：(剥離方向は下図参照)
0.1N~0.7N(10.2gf~71.4gf)尚、本規格値は、出荷時に適用。
(但し、輸送時に剥離が発生しない事。)

PEELING OFF FORCE OF TOP TAPE
0.1N~0.7N(10.2gf~71.4gf)(PEELING DIRECTION AS SHOWN IN FOLLOWING FIG.)
THIS REQUIREMENT SHOULD BE APPLIED AT SHIPMENT
PEEL OFF SHOULD NOT BE ALLOWED,
DURING TRANSPORTATION



4. 材料
キャリアテープ：ポリプロピレン (PP) CARRIER TAPE:POLYPROPYLENE
トップテープ：PET, PE, PEF TOP TAPE:PET,PE,PEF
リール：ポリスチレン (PS) REEL:POLYSTYREN(PS)
<リサイクル材を含む> <RECYCLE MATERIAL CONTAINED>

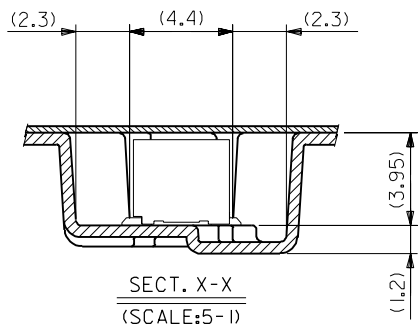
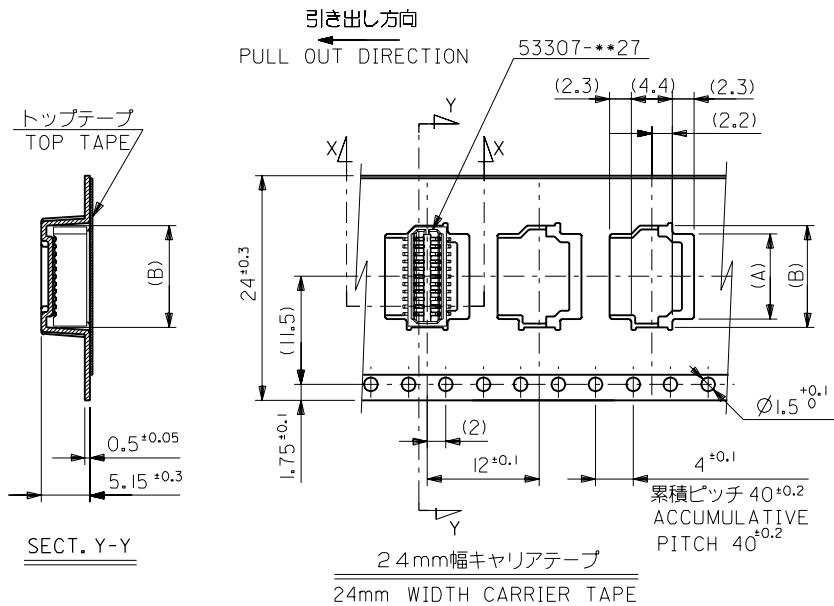
16	17.5	9.3	7.5	53307-189I	18	
		8.5	6.7	53307-169I	16	
		7.7	5.9	53307-149I	14	
		6.9	5.1	53307-129I	12	
		6.1	4.3	53307-109I	10	
キャリアテープ幅 CARRIER TAPE WIDTH		C	(B)	(A)	ENG. NO.	極数 CIRCUIT

材料 MATERIAL		注記参照 SEE NOTES		molex MOLEX-JAPAN CO.,LTD. 日本モレックス株式会社	
仕上げ FINISH		---		REVISE ONLY ON CAD SYSTEM	
適用電線範囲 WIRE RANGE		---		TITLE 名称	
被覆外径 INS. RANGE		---		0.8 B-To-B WAFER Assy SMT Embstp Pkg	
DRAWN BY 91/11/22 K.ASAKAWA		CHK'D BY 00/12/20 T.IITO		DWG. NO. (SHEET 1 OF 2) REV	
APP'D BY 00/12/20 M.FUKUSHIMA		尺度 SCALE		SD-53307-***9I B	
角度 ANGLE	±3°	記号 LTR	変更内容 REVISION RECORD	DR. CHK.	日付 DATE
30°以上 OVER	+0.3	B	変更 (JC2001-0479)	1.1	00/12/20
10°以上 30° UNDER	+0.25	A	変更 (JC70882)	1.2	97/4/1
10° UNDER	+0.2	O	新規作成 (J11065)	1.0	91/11/22
一般公差 GENERAL TOLERANCES					

THIS DRAWING CONTAINS INFORMATION THAT IS PROPRIETARY TO MOLEX(JAPAN) AND SHOULD NOT BE USED WITHOUT WRITTEN PERMISSION
本図面は日本モレックス(株)の所有する情報を含むもので 当社の許可なく複製を禁止する。
EN-01C(032)MXJ-32

5949924A.S05

DWG. NO.
SD-53307-**-91



24	25.5	14.1	12.3	53307-3091	30
		13.3	11.5	53307-2891	28
		12.5	10.7	53307-2691	26
		11.7	9.9	53307-2491	24
		10.9	9.1	53307-2291	22
		10.1	8.3	53307-2091	20
キャリアテープ幅 CARRIER TAPE WIDTH	C	(B)	(A)	ENG. NO.	極数 CIRCUIT

材料 MATERIAL		SHEET 1 OF 2参照 REFER TO SHEET 1 OF 2		molex MOLEX-JAPAN CO.,LTD. 日本モレックス株式会社	
仕上げ FINISH		//		REVISE ONLY ON CAD SYSTEM	
適用電線範囲 WIRE RANGE		//		TITLE 名称 0.8 B-To-B WAFER Assy SMT Embstp Pkg	
被覆外径 INS. RANGE		//		DWG. NO. (SHEET 2 OF 2) REV SD-53307-**-91 B	
DRAWN BY '91/11/22 K.ASAKAWA		CHK'D BY '00/12/20 T.ITO			
APP'D BY '00/12/20 M.FUKUSHIMA		尺 度 SCALE		//	

角度 ANGLE	±3°
30°以上 OVER	+0.3
10°以上 30°未満 OVER UNDER	+0.25
10°未満 UNDER	+0.2
一般公差 GENERAL TOLERANCES	

記号 LTR	変更内容 REVISION RECORD	DR. CHR.	日付 DATE
B	変更 (JC2001) REVISED (-0479)	Y.A.	'00/12/20
A	変更 (JC70882) REVISED	Y.A.	'97/4/1
O	新規作成 (J11065) PROPOSED	Y.A.	'91/11/22

THIS DRAWING CONTAINS INFORMATION THAT IS PROPRIETARY TO MOLEX(JAPAN) AND SHOULD NOT BE USED WITHOUT WRITTEN PERMISSION
本図面は日本モレックス(株)の所有する情報を含むもので 当社の許可なく複製を禁止する。
EN-OIC(032)MXJ-32

DIMENSIONS IN METRIC DO NOT SCALE DRAWING

5949924A.S06